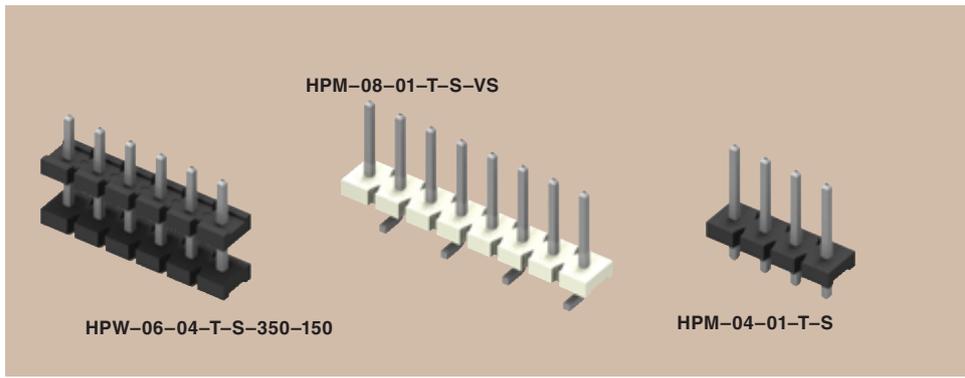


(5,08mm) .200"

HPM, HPW 系列



# 电源插头和板间堆叠器

配接:  
HPF

## 技术规格

如需了解所有技术规范, 请访问 [www.samtec.com?HPM](http://www.samtec.com?HPM)

绝缘体材料:

玻璃填充的  
聚酯 (TH)  
液晶聚合物 (SMT)

端子材料:

铜合金  
电镀:  
50 $\mu$ m (1.27 $\mu$ m) 的镍底上镀锡  
工作温度范围:  
-55°C 至 +105°C  
符合 RoHS 规范要求:  
是

加工:

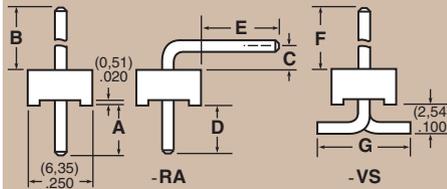
可无铅焊接:  
是  
SMT 引线共面度:  
最大 (0.20mm) .008" (02-15)  
最大 (0.25mm) .010" (16-20)



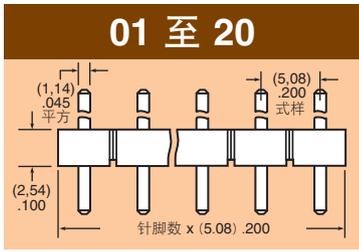
**HPM**  
= 高温  
大功率插头

额定电流		
环境 温度	HPM/HPF	
	2 针	4 针
20°C	25A	22A
40°C	24A	19A
60°C	17A	15.5A
75°C	14.4A	12.7A

根据下面的图表指定引线式样。



引线式样	A	B	C	D	E	F	G
-01	(4.57) .180	(11.94) .470	—	—	—	(10.72) .422	(8.64) .340
-02	(4.57) .180	(13.21) .520	(2.54) .100	(4.57) .180	(8.08) .318	(12.24) .482	(8.38) .330
-04	(4.09) .161	(21.06) .829	(4.95) .195	(3.96) .156	(13.82) .544	—	—
-05	(4.57) .180	(3.81) .150	—	—	—	—	—



注: 有些长度、式样和选项为  
非标准型, 不可退换。

配接:  
HPF

## 技术规格

如需了解所有技术规范, 请访问 [www.samtec.com?HPW](http://www.samtec.com?HPW)

绝缘体材料:

液晶  
聚合物

端子材料:

铜合金  
电镀:  
50 $\mu$ m (1.27 $\mu$ m) 的镍底上镀锡  
工作温度范围:  
-55°C 至 105°C  
符合 RoHS 规范要求:  
是

加工:

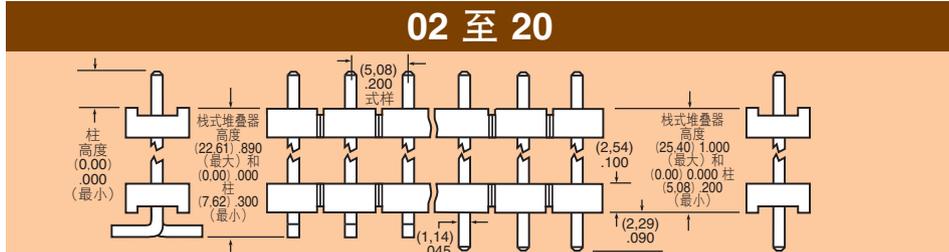
可无铅焊接:  
是  
SMT 引线共面度:  
最大 (0.20mm) .008"



**HPW**  
= 高温  
大功率

—“XXX”  
= 栈式堆叠器高度 (以英寸),  
增量为 (0.13mm) 0.005"  
例如: -250 =  
(6.35mm) .250"

—“XXX”  
= 柱高度  
(以英寸)  
-VS  
= 表面贴装  
(最少 2 个针  
脚/排)



注: 有些长度、式样和选项为  
非标准型, 不可退换。